## WPI =====

- TI Paste for low temp. soldering in radioelectronic technology contains powdered solder, tri:ethanolamine and specified fraction of synthetic fatty acids
- AB SU1646754 The paste contains (wt.%): triethanolamine 2.47-6.0, carbonic acids (the 10-16C fraction of synthetic fatty acids) 4.53-11.0 and balance powdered solder.
  - USE/ADVANTAGE The paste is used for assembling soldered joints and cables. The paste spreading during solder fusion is reduced, as is the quality of solder particles removed from the contact fusion zone by the flux. This paste retains its properties for at least a year, and is non-corrosive and it enables the component to be washed after brazing. Bul.17/7.5.91(Dwg.0/0)
- PN SU1646754 A 19910507 DW199215 002pp
- PR SU19894698359 19890531
- PA (ODEL-R) ODESS ELECTROTECH
- IN AMBROKH R V; DENGA E M; GROSSMAN A Y A
- MC E10-B03B E10-C04L L03-A01B6 L03-H04E6
  - X24-A01A
- DC E13 E17 L03 M23 P55 X24
- IC B23K35/24
- AN 1992-121438 [15]



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

## (1) SU (1) 1646754 A1

(51)5 B 23 K 35/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ ПРИ ГКНТ СССР

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

-

(21) 4698359/27

(22) 31.05.89

(46) 07.05.91. Бюл. № 17

(71) Одесский электротехнический институт связи им. А.С.Полова

(72) Э.М.Деньга, Р.В.Амброх и А.Я.Гроссман

(53) 621.791.3 (088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР № 1338994, кл. В 23 К 35/24, 14.01.86.

(54) ПАСТА ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ

(57) Изобретение относится к пайке, в частности к составам пасты для пайки при монтажно-сборочном производстве радио-электронной аппаратуры, например для распайки разъемов, кабелей. Цель изобре-

тения - уменьшение растекания пасты при оплавлении и количества частиц припоя, выносимых флюсом из зоны оплавляемого контакта. Паста содержит, мас. %: фракция синтетических жирных кислот (СЖК) С10С16 4.53 - 11.0; тризтаноламин 2.47 - 6.0; порошковый припой - остальное. Использование не отдельных карбоновых кислот, а фракции СЖК позволяет повысить коэффициент удержания припоя для различных припоев до 94 - 98%. Флюс-связующее припойной пасты готовят при температуре 60 -70°С. Коэффициент растекаемости по меди припоев различных марок, содержащихся в пасте, составляет 1.5 - 1.7 при температуре 185 - 200°C. Остатки флюс-связующего легко отмываются после пайки. 2 табл.

Изобретение относится к пайке, в частности к составу припойных паст, применяемых для монтажа электронных схем, распайки разьемов, кабелей и т.п., и может быть использовано в радиотехнической, электронной, приборостроительной и других отраслях промышленности.

Целью изобретения является уменьшение растекания пасты при оплавлении и количества частиц припоя, выносимых флюсом из зоны оплавляемого контакта.

Предлагвемая паста содержит, мас.%:

Фракция синтетических жирных кислот C<sub>10</sub>—C<sub>16</sub>

4.53 - 11.0 2.47 - 6.0

Тризтаноламин Порошкообразный

припой Остальное

Фракция синтетических жирных кислот (СЖК) С10-С16 в качестве основных компо-

нентов содержит каприновую (С10), ундекановую (С11). лауриновую (С12), тридекановую (С13), миристиновую (С14), пентодекановую (С15) и пальмитиновую (С16) нормальные монокарбоновые кислоты, а в качестве примесей - монокарбоновые кислоты изостроения, дикарбоновые кислоты, а также непредельные кето- и оксикарбоновые кислоты, что обеспечивает необходимую реологию пасты. Приготовление пасты происходит при нагревании смеси фракции СЖК С10-С16 и триэтаноламина до 60 - 70°С при постоянном перемешивании до однородного состояния, после чего смесь охлаждают до комнатной температуры. После этого флюс-связующее смешивают с порошкообразным припоем.

В табл. 1 приведены составы пледлагаемой пасты. В табл. 2 приведены результаты измерений коэффициентов удержания металла припоя на контактной площадке платы при плавлении пасты при определенном температурном режиме. Коэффициент удержания металла равен 100% при отсутствии выноса флюсом частиц припоя с оплавляемой площадки, уменьшаясь с увеличением этого выноса. Результаты усреднены по 50 контактным площадкам.

Из табл.2 видно, что коэффициент удержания металла для различных припоев выше в случае предлагаемой пасты.

Проведенные испытания припойной пасты показывают пригодность ее для работы 15 уже при 185 — 195°С, при которых обеспечивается высокое качество пайки и средние значения коэффициентов растекаемости припоя (ПОС-61, ПОСВи 36-4, ПСрОС 3-58) по меди и латуни имеют значения не менее 20-1.5 — 1.7. Паста сохраняет свои свойства в

течение не менее одного года, не вызывает коррозии, изделия после пайки легко отмываются, так как флюс-связующее является детергентом.

Формула изобретения

Паста для низкотемпературной пайки, содержащая карбоновые кислоты, триэтаноламин и порошкообразный припой, о тличаю щаяся тем, что, с целью уменьшения растекания пасты при оплавлении и количества частиц припоя, выносимых флюсом из зоны оплавляемого контакта, она содержит в качестве карбоновых кислот фракцию синтетических жирных кислот С10—С16 при следующем соотношении компонентов, мас. %:

 Фракция синтетических жирных кислот С<sub>10</sub>-С<sub>16</sub>
 4.53 - 11.0

 Триэтаноламин
 2,47 - 6,0

 Порошкообразный припой
 Остальное

Таблица 1

Компоненты состава	Содержание, мас. % в составе					
пасты	1	2	3	4	5	
Фракция СЖК С10 - С16	4,53	9.25	11,0	9,89	8,69	
Триэтаноламин	2.47	5.04	6.0	4,40	5.60	
Порошкообразный припой	93	85,71	83	85,71	85,71	

Таблица 2

Паста припойная	Коэффициент удержания металла, %			Время достиже- ния температуры	
	ПОС-61	ПСрОС 3-58		оплавления, с	
Известная	93	89	200	3	
Предлагаемая	98	95	. 200	3	

Составитель Л.Абросимова Техред М.Моргентал Корректор А.Осауленко

Заказ 1368

Редактор Н.Бобкова

Тираж 520

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5